

<<电子产品结构与工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品结构与工艺>>

13位ISBN编号：9787563514977

10位ISBN编号：756351497X

出版时间：2008-2

出版时间：北京邮电

作者：万少华

页数：202

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品结构与工艺>>

内容概要

本书针对机电类专业的学生在以后开发研制电子产品工作中应该掌握的有关电子产品结构与工艺的相关知识作了较系统的介绍。

全书共7章，主要内容包括：电子产品制造概要；印制电路板设计与制作；焊接工艺；安装工艺；产品可靠性与防护；电子产品整机结构及外观审美设计；电子产品技术工艺文件与体系。

本书内容涉及知识面广，而且图文并茂，浅显易懂，既可作为高职院校电子类专业教材，还可作为电子产品设计和制造等专业技术人员的参考书籍。

<<电子产品结构与工艺>>

书籍目录

绪论第1章 电子产品制造概要 1.1 对电子产品的基本要求 1.1.1 生产方面对电子产品的要求 1.1.2 工作环境对电子产品的要求 1.1.3 使用方面对电子产品的要求 1.1.4 电子产品设计制造的主要依据 1.2 电子产品整机制造工艺 1.2.1 整机制造的一般顺序 1.2.2 整机制造的主要工作内容 1.2.3 整机制造的工艺种类和规程 小结 思考与复习题第2章 印制电路板设计与制作 2.1 印制电路板概述 2.1.1 印制电路板的组成 2.1.2 印制电路板的基材 2.1.3 印制电路板的种类 2.2 印制电路板的设计 2.2.1 印制电路板上的元器件布局和布线原则 2.2.2 印制导线的尺寸和图形 2.2.3 印制电路板的设计方法和步骤 2.3 印制电路板的手工制作 2.3.1 手工制作方法 2.3.2 制作工艺流程 小结 思考与复习题第3章 焊接工艺 3.1 焊接的基础知识 3.1.1 焊接的概念 3.1.2 焊接方法的分类 3.1.3 锡焊的实用性特点与焊接条件 3.1.4 锡焊形成的工艺过程 3.1.5 焊点形成的必要条件 3.2 焊料和助焊剂 3.2.1 焊料 3.2.2 助焊剂 3.3 手工焊接 3.3.1 焊接工具 3.3.2 手工焊接方法 3.3.3 拆焊 3.4 焊接的质量检验 3.4.1 外观观察检验法 3.4.2 带松香重焊检验法 3.4.3 其他焊接缺陷 3.5 机器焊接简介 3.5.1 浸焊 3.5.2 波峰焊和再流焊 小结 思考与复习题第4章 安装工艺 4.1 安装概述 4.1.1 安装工艺的整体要求 4.1.2 安装的工艺流程 4.1.3 安装工艺中的紧固和连接 4.2 安装准备工艺 4.2.1 器件的检验、老化和筛选 4.2.2 元器件的预处理 4.2.3 导线的加工 4.3 典型元器件的安装 4.3.1 集成电路的安装 4.3.2 集成电路插座的安装第5章 产品可靠性与防护第6章 电子产品整机结构及外观审美设计第7章 电子产品技术工艺文件与体系参考文献

<<电子产品结构与工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>